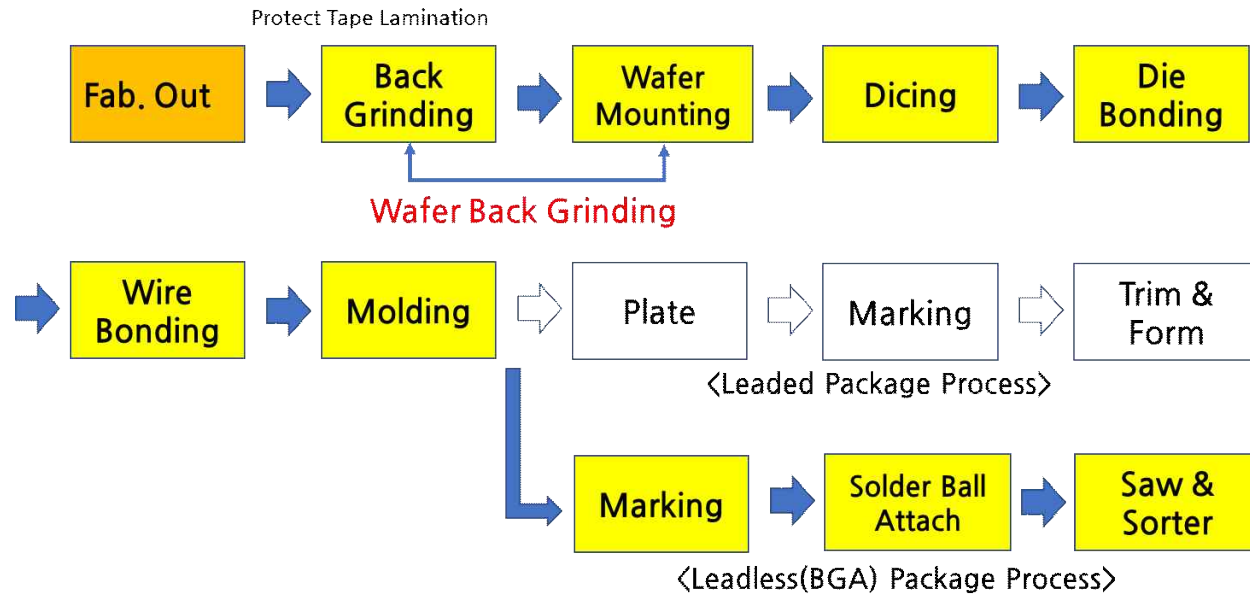


- * 조기 취업자는 가능하면 기말시험 보러 오는 날 행정조교에게 제출.
- * A4용지 상단에 학년, 반, 학번, 이름을 1줄로 적고 그 아래 부분에 작성하되 다른 사람이 알아볼 수 있도록 정자로 또박또박 작성함. 직접 손으로 작성.
- * 1번 : A4 최소 2장, 2번 : A4 최소 1장 이상 작성

1. 반도체 패키징 공정의 일반적인 순서이다. 각 공정에 대한 정의와 진행 내용을 간략히 요약하여 제출하시오.



- 1) Wafer Back Grinding
- 2) Wafer Mounting
- 3) Dicing
- 4) Die Bonding
- 5) Wire Bonding
- 6) Molding
- 7) Marking
- 8) Solder Ball Attach
- 9) Saw & Sorter

2. 조기 취업자는 자신의 업무 분야에 대하여 요약하여 제출하시오.